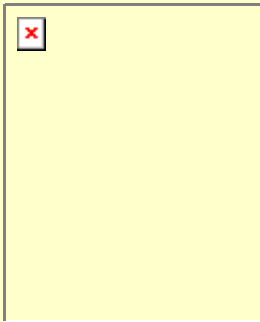


## 本期封面



2001年11期

栏目:

DOI:

论文题目: SiC晶须增强6061A1基复合材料的热机械疲劳性能 I. 应力应变行为

作者姓名: 钱立和 王中光 户田裕之 小林俊郎

工作单位: 中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室, 沈阳1100116

通信作者: 钱立和

通信作者Email: [dlhqian@yahoo.com](mailto:dlhqian@yahoo.com)

文章摘要: 对体积分数为15%和28%的SiC<sub>w</sub>/6061A1复合材料进行了同相和反相热机械疲劳(TMF)实验, 研究了疲劳过程中的应力应变行为和变形机制结果表明, 两种材料在同相和反相加载下均表现为循环软化; 反相加载产生拉伸平均应力, 同相加载产生压缩平均应力; 在相同应变范围下, 高体积分数复合材料的循环应力范围比低体积分数复合材料的应力范围大。

关键词: 6061A1基复合材料, SiC晶须

分类号: TB33, TG111

关闭